

# SAS (Semiconductor & Assembly Solutions) 事業部

## 製品紹介

### フラックス

アルファのフラックスは、鉛フリーソルダリングにおける高密度実装に対応いたします。SAC305 (Sn/3.0Ag/0.5Cu) やSACXをはじめとする、あらゆる鉛フリーはんだ合金でお使いいただけます。

鉛フリーはんだ特有のぬれ性の悪さを解消し、ICリードやコネクタ部品のブリッジの低減等に効果的です。特に、修正が困難なスルーホール部品の充填率においても、確かな上がりを実現します。低残渣且つ粘着性がないため良好なピンテスト性が得られます。独特の活性システムにより、フラックスの低固形分化が可能です。

#### 液状フラックス一覧 (抜粋)

フラックス タイプ	製品名	ハロゲン *注1	固形分 wt%	比重	区分 J-STD-004	特長
ロジン系 無洗浄	SMX022	含む	7.50%	0.82	ROL0	ウェーブはんだ付け工程用 アルコールベース 鉛フリー汎用品、通信機器用、非腐食性残渣 のため電気絶縁性良好 Telcordia規格準拠品
有機酸系 水洗浄	OA5298HF4	ZERO	100%	1.08	ORH0	ウェットバック工程用 純水洗浄 耐熱性に優れる 高融点はんだ用 スピコートもしくはディップ転写にて適用
ロジン系 溶剤洗浄	R5003	ZERO	67%	1.06	ROL0	ウェットバック工程用 非活性タイプ 腐食性ゼロ スピコートもしくはディップ転写にて適用
ロジン系 無洗浄	RM5776	ZERO	63%	1.07	ROL0	ウェットバック工程用 弱活性の低粘度タイプ 表面に光沢を与えるよう設計
ロジン系 水洗浄	R100-40	ZERO	40%	0.9	ROL0	MIL-F-14256 (Rタイプ) に適合 めっき品質検査用
ロジン系 溶剤洗浄	RA711-35B	含む	35%	0.88	ROH1	MIL-F-14256 (RAタイプ) に適合 フラックス残渣は速乾性
有機酸系 水洗浄	K183SCG	ZERO	17.5%	0.87	ORH0	リードめっき用 ハロゲン元素、アルカリ金属を極力抑えたタイプ

フラックス タイプ	製品名	ハロゲン *注1	固形分 wt%	比重	区分 J-STD-004	特長
有機酸系 水洗浄	OA3541HF	ZERO	22%	0.93	ORH0	リードめっき用 洗浄性は抜群に優れる

### ペーストフラックス一覧（抜粋）

フラックス タイプ	製品名	ハロゲン *注1	粘度 Pas	転写	印刷	区分 J-STD-004	特長
水溶性 水洗浄	WS9160-M3	ZERO	30	○	○	ORH0	BGAボール搭載用 水溶性フラックス標準品 洗浄性良好 印刷、ディスペンス、ピン転写、ボール 転写にて適用
水溶性 水洗浄	WS9190	ZERO	100	○	○	ORH0	BGAボール搭載用 高粘度タイプ ボール落ち対策品 印刷、ピン転写、ボール転写にて適用
ロジン系 溶剤洗浄	RA9141	0.2wt%	25	○	○	ROL1	BGAボール搭載用 RAタイプ ボール表面光沢改善 印刷、ピン転写、ボール転写にて適用
ロジン系 溶剤洗浄	OL233HF	ZERO	25	○	○	ROL0	BGAボール搭載用 RAタイプ ぬれ広がり性改善 印刷、ピン転写、ボール転写にて適用